



【TSIA 新聞稿 2019.10.3】

**2019 TSIA年會即將於10/31重磅登場**  
**特邀微軟沈向洋執行副總裁AI專題演講**  
**並舉辦5G論壇「台灣半導體產業在5G時代的機會與挑戰」**  
**預期將群聚國內外產官學研半導體菁英於新竹矽谷!**

TSIA將於2019年10月31日(四)14:00~17:30假新竹國賓大飯店10樓國際會議廳舉辦年會。年會將由理事長台積電劉德音董事長親自主持，邀請到微軟沈向洋執行副總裁(人工智慧及研究團隊)擔任Keynote演講嘉賓，於會中發表「The Future of AI and Technology」專題演說，並由聯發科技蔡力行執行長主持「5G論壇-台灣半導體產業在5G時代的機會與挑戰」，邀請多位產官學研知名專家和與會者互動，共同尋求台灣半導體產業持續成長之契機。同時會中也將頒發2019年 TSIA半導體獎，期望年輕精英人才能進入前瞻半導體領域。

近年來陸續看到各項新科技的應用與需求，以及半導體所帶來的革新，尤其是人工智慧 ( AI ) 與5G的應用，可望為半導體產業開創新藍海。因此，Keynote AI專題演說及5G大論壇也將是本次年會的主軸及最大亮點。

首先，本會特邀微軟沈向洋執行副總裁擔任keynote speech嘉賓，講題為「The Future of AI and Technology」。沈執行副總裁在微軟已有20幾年的經驗，曾協助成立微軟中國研究院，擔任過微軟亞洲研究院院長及微軟全球副總裁，專責開發微軟Bing搜尋引擎，目前領導微軟人工智慧及研究團隊，讓我們拭目以待這場精闢的演講。

壓軸將是由聯發科技蔡力行執行長主持的【5G論壇】，主題為「台灣半導體產業在5G時代的機會與挑戰」。邀請科技部許有進政務次長、廣達林百里總裁、Microsoft 沈向洋執行副總裁、日本NTT DoCoMo Takehiro Nakamura資深副總、中華電信林國豐執行副總、台積電張曉強副總經理擔任與談人。聯發科技為世界領先的5G通訊晶片設計業者，蔡執行長將引領論壇討論，擘劃5G願景。科技部主管台灣科技發展，推動5G研發計畫，許政次將分享科技部在5G與半導體產業的政策方向。廣達集團林總裁為台灣電子資訊產業發展的重量級人物，將就5G

與AI的結合，提出超級互聯世界的願景。Microsoft為世界AI與軟體產業的佼佼者，沈執行副總將分享5G潮流下AI應用的觀點。日本NTT DoCoMo積極採用5G，已於今年九月在日本提供5G預商用服務，Nakamura資深副總將帶來珍貴經驗。中華電信為台灣電信營運的龍頭，林執行副總將對於台灣5G建置與應用，分享寶貴意見。台積電掌握世界先進晶片製造的領先地位，張副總經理將由半導體產業的角度，洞察5G產業發展。來賓皆為科技界的傑出菁英，可說是一時之選。預期透過產、官、學、研不同的觀點，共同激盪出5G時代願景與藍圖，精彩可期。

同時，會中將頒發2019 TSIA半導體獎，鼓勵優秀年輕學子進入前瞻半導體領域。2019年TSIA半導體獎(具博士學位之新進人員)由國立清華大學資訊工程系李濬屹助理教授及國立交通大學國際半導體產業學院管延城助理教授獲獎。TSIA半導體獎(博士研究生)則由台大、交大、清大、成功、中山等5校10位博士班同學獲獎，詳見2019年7月號TSIA第89期簡訊電子書p.27-39頁詳細報導: <https://www.tsia.org.tw/Publications?nodeID=28>。

#### **關於 TSIA：**

台灣半導體產業協會成立於1996年，是一個以"關心產業發展"為出發點的民間團體，透過協會的活動凝聚業界對產業發展的共識，以促成競爭中的合作，提升整體產業競爭力並促進整體產業的健全發展。TSIA現有研發、設計、製造、封裝、測試、設備、材料等會員廠商約140家，約佔台灣整體IC產業產值的百分之八十。更多資訊，請上[www.tsia.org.tw](http://www.tsia.org.tw)查詢。活動詳細連結網址: <https://reg.tsia.org.tw/2019TSIAconvention/>。

#### **新聞聯絡人：**

台灣半導體產業協會 吳素敏協理 Tel:+886-3-591-3477, Email:[julie@tsia.org.tw](mailto:julie@tsia.org.tw)